

# MECATRONIC

CONNECTION 2016

# PLASTRONIC

CONNECTION 2016

## COMPTE RENDU MECATRONIC CONNECTION & PLASTRONIC CONNECTION 2016

Après Grenoble en 2014, c'est Oyonnax qui a accueilli cette année la 8ème édition de Mecatronic Connection et la 2ème édition de Plastronic Connection, le 12 et 13 octobre 2016. Ces salons sont organisés par First Connection en partenariat avec Thésame et S2P-Smart Plastic Products, avec le soutien de Mont Blanc Industries et Plastipolis et l'appui institutionnel de la Ville d'Oyonnax, de la Communauté de Commune du Haut-Bugey et de l'AEPV.

Connaissant un succès grandissant, ces événements ont réuni en 2016 plus de 150 entreprises européennes, avec comme objectif d'amorcer des partenariats technologiques entre des offreurs (PME, start-up, ...) spécialisés en mécanique et plastronique et des donneurs d'ordres (grands groupes, ETI, ...) issus de domaines très variés tels que l'automobile, l'aéronautique, la défense, le ferroviaire, le médical et les équipements industriels ...

Une quinzaine de **conférences** sur des sujets innovants ont également présentées et un **Fablab plastronique** a offert l'opportunité aux participants de mener leur propre projet plastronique : de la conception à la fabrication d'une pièce. L'Espace était animé en plein cœur du salon par la société S2P - Smart Plastic Products.

### CHIFFRES CLES 2016

★ **165** entreprises participantes

**115** donneurs d'ordres.

**50** fournisseurs et offreurs de technologies.

★ **1 820** rendez-vous B2B organisés sur les deux jours.

★ **16** rendez-vous organisés par entreprise en moyenne sur les deux jours, dont **12** pré-organisés et **4** organisés sur place.

★ **4** rendez-vous par entreprise ayant mené à un suivi à court terme (rendez-vous ultérieur, consultation, ...).

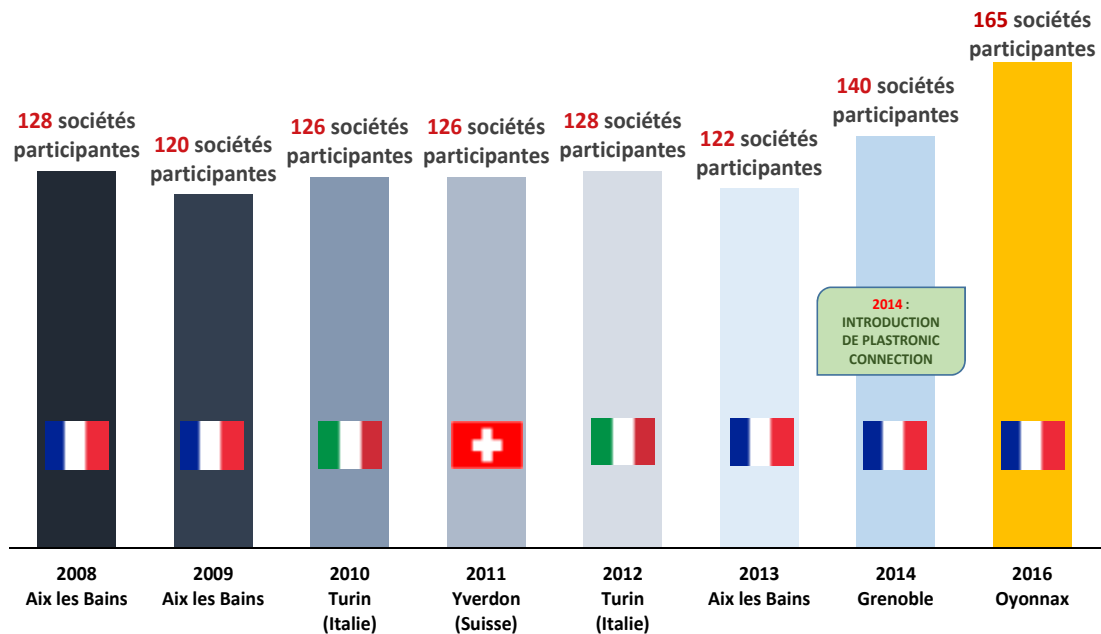
★ **14** conférences thématiques.

Plus de détails sur le programme présenté en 2016 sur les pages suivantes :

- ★ Statistiques 2016 - [Page 2](#)
- ★ Conférences & Fablabs en 2016 - [Page 3](#)
- ★ Liste des exposants présents en 2016 - [Page 4](#)
- ★ Liste des donneurs d'ordres présents en 2016 - [Page 5](#)
- ★ Partenaires- [Page 6](#)

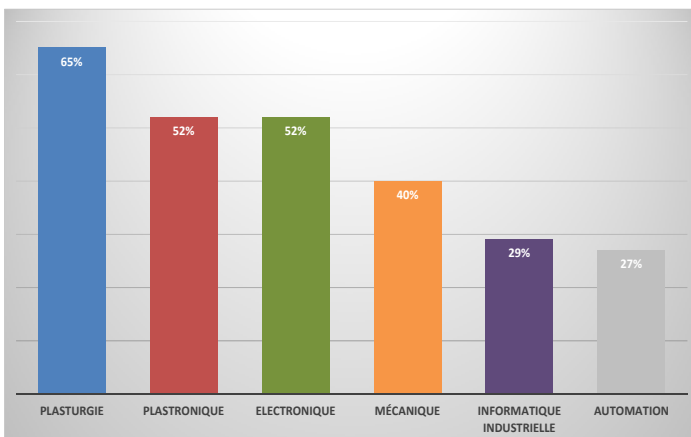
# STATISTIQUES 2016

## Historique de participation à Mecatronic & Plastronic Connection

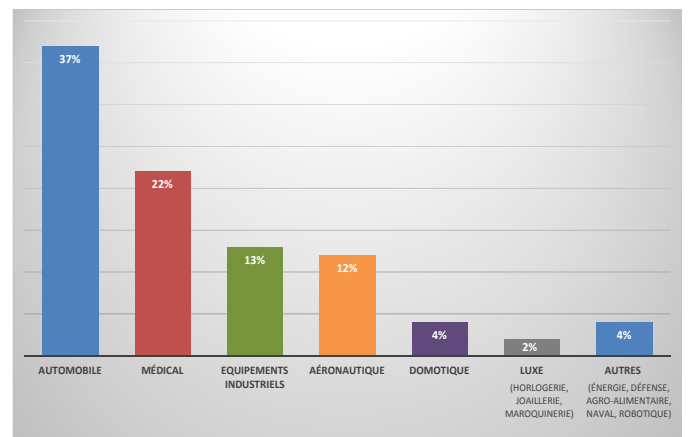


## Statistiques de fréquentation en 2016 par catégorie de participants

### Répartition « métier » des exposants



### Répartition « secteur » des donneurs d'ordres



## Les points forts de Mecatronic & Plastronic Connection\*

À L'UNANIMITÉ (DONNEURS D'ORDRES ET EXPOSANTS)	LES + POUR LES DONNEURS D'ORDRES	LES + POUR LES EXPOSANTS
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ciblage et qualité des contacts</li> <li>* Qualité de l'organisation</li> <li>* Les thématiques : mécatronique et plastronique</li> <li>* Proportion du salon, à taille humaine</li> <li>* Assistance et accueil des organisateurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Alliance des conférences et rencontres sur un même événement</li> <li>* L'organisation logistique (hotel, déjeuner sur place, ...)</li> <li>* L'accompagnement et le suivi de First Connection</li> <li>* La personnalisation du service</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Présence massive de donneurs d'ordres de qualité</li> <li>* Renouvellement des donneurs d'ordres</li> <li>* Proximité des organisateurs</li> <li>* Nombre important de contacts par rapport à un salon classique</li> </ul>

\*Basé sur les réponses aux questionnaires de satisfaction au 15/11/2016

# CONFERENCES & FABLABS EN 2016

## MERCREDI 12 OCTOBRE 2016

10.00 - 10.30	<b>CONFERENCE 1</b> : «Introduction à la Plastronique : de la théorie à la pratique, comment aborder la question de l'utilisation de ces technologies ?» <i>Intervenant</i> : Amaury Veille, S2P - Smart Plastic Products
10.30 - 11.00	<b>CONFERENCE 1bis</b> : «Une nouvelle approche de l'IME (In Mold Electronic)» <i>Intervenant</i> : Olivier Dassonville, Sintex NP
11.00 - 11.30	<b>CONFERENCE 2</b> : «Modélisation et caractérisation d'inducteurs 2D et 3D réalisés en technologies Plastroniques pour applications de mesures inductives de proximité» <i>Intervenant</i> : S. Kamotesov, S2P - Smart Plastic Products
12.00 - 12.30	<b>CONFERENCE 3</b> : «PULSCE : Système de récupération d'énergie vibratoire pour l'alimentation de capteurs» <i>Intervenants</i> : Adrien Badel et Fabien Formosa, Université Savoie Mont Blanc
14.30 - 15.00	<b>CONFERENCE 4</b> : «Matériaux polymères déformables à volonté pour plus de fonctionnalité : quels procédés et applications sectorielles ?» <i>Intervenant</i> : Alexis Robert, Loma Innovation
15.00 - 16.30	<b>FABLAB PLASTRONIQUE</b> : «Présentation d'un démonstrateur vous permettant de participer à l'élaboration et à la fabrication d'un hybride, combinant 2 technologies plastroniques (technologie LDS-LPKF et technologie de tampographie).»
16.30 - 17.00	<b>CONFERENCE 5</b> : «Solutions numériques avancées de dépôt de matériaux pour l'électronique imprimée et l'impression 3D intelligente» <i>Intervenants</i> : Nicolas Bernardin, Ceradrop
17.00 - 17.30	<b>CONFERENCE 6</b> : «Electronique flexible et procédés polymères : une nouvelle approche pour les produits plastiques intelligents et 3D» <i>Intervenants</i> : Olivier Dassonville, Sintex NP et Lionel Tenchine, IPC
17.30 - 18.00	<b>CONFERENCE 7</b> : «Robotique collaborative : présentation d'une solution novatrice et alternative à la robotique industrielle traditionnelle» <i>Intervenant</i> : Christophe Cadieu, FIT

## JEUDI 13 OCTOBRE 2016

09.30 - 10.00	<b>CONFERENCE 8</b> : «Les avancées de la plastronique : innovations, enjeux et phases clés indispensables à la réalisation de fonctions» <i>Intervenant</i> : Amaury Veille, S2P - Smart Plastic Products & Delphine Béchevet, Hepia (HES-SO Genève)
10.00 - 10.30	<b>CONFERENCE 9</b> : «Chaire d'Excellence Industrielle MINT : Comment relever les défis scientifiques de la Plastronique pour satisfaire les besoins industriels ?» <i>Intervenant</i> : Cécile Venet, Schneider Electric
10.30 - 11.00	<b>CONFERENCE 10</b> : «Présentation d'Axandus, accélérateur de Start-Up dans le domaine des capteurs, des objets connectés et des produits mécatroniques» <i>Intervenant</i> : Jean-Baptiste Yvon, Axandus
11.00 - 12.30	<b>FABLAB PLASTRONIQUE</b> : «Présentation d'un démonstrateur vous permettant de participer à l'élaboration et à la fabrication d'un hybride, combinant 2 technologies plastroniques (technologie LDS-LPKF et technologie de tampographie).»
12.30 - 13.00	<b>CONFERENCE 11</b> : «Prothèses Bioniques et Biomécatronique : avancées et perspectives d'évolutions industrielles du marché de la bionique humaine» <i>Intervenant</i> : Guillaume Bonifas - Orthoprothésiste, Handy Bionic
14.30 - 15.00	<b>CONFERENCE 12</b> : «Systèmes électroniques intégrés pour l'instrumentation in situ de structures composites : le projet Compositronic» <i>Intervenant</i> : Manuel Lagache, Laboratoire Symme
15.00 - 15.30	<b>CONFERENCE 13</b> : «Impression 2D de capteurs et microsystèmes sur différents types de support» <i>Intervenant</i> : Philippe Passeraub, Hepia (HES-SO Genève)

# LISTE DES EXPOSANTS PRÉSENTS EN 2016

**A.E.M. ATELIERS ELECTRO MECANIQUE VAYRAC**

**ADDUXI**

**AEROPLAST**

**ALBIS PLASTIC**

**ANNECY ELECTRONIQUE SAS**

**APNYL**

**AUGE MICROTECHNIC GROUP**

**AURAY PLAST**

**AXEMBLE**

**BECKHOFF AUTOMATION**

**BOSCH EMS FRANCE**

**BP DESIGN**

**CEA LITEN**

**CEDRAT TECHNOLOGIES**

**CERADROP**

**CRITT INFORMATIQUE**

**DIGILAC**

**EFS**

**EOLANE**

**FAIVELEY PLAST**

**FIT**

**GALLEZ**

**GROSPERRIN**

**GROUPE ELVIA PCB**

**HEPIA GENEVE**

**HPM GROUPE**

**IN PLAST**

**IPC - INNOVATION PLASTURGIE COMPOSITES**

**JACQUEMET**

**LOMA INNOVATION**

**M2ES TECHNOLOGIES**

**MDP**

**MEREM ELECTRONIQUE**

**MG2**

**MID SOLUTIONS GMBH**

**MILLET PLASTICS GROUP**

**MIP (MOULAGE INJECTION PLASTIQUE)**

**ON PLAST**

**PLASTIBELL**

**PRECI-DIP SA**

**PROTO LABS**

**RJG**

**S2P - SMART PLASTIC PRODUCTS**

**SABIC INNOVATIVE PLASTICS**

**SINTEX NP**

**TEHCI RHONE ALPES**

**THESAME**

**YASKAWA**

# LISTE DES DONNEURS D'ORDRES PRÉSENTS EN 2016

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS  
AIRBUS GROUP  
ALL CIRCUITS  
AUTOMOTIVE EXTERIORS EUROPE  
AVENTICS  
BIORAD  
BOLLHOFF  
BOSCH REXROTH  
BREMBO  
C&K COMPONENTS  
CAR PARTS INDUSTRIES SPRL  
CARDIAGS  
CENTRALP SAS  
CONDUCTIX-WAMPFLER  
DECATHLON - MARQUE GEONAUTE  
DIAGNOSTICA STAGO  
DURA AUTOMOTIVE  
DZAIN  
EDF/R&D/ OPEN INNOVATION  
EFI AUTOMOTIVE  
EMS S.A. (ELECTRO MEDICAL SYSTEMS)  
EOLANE  
FAURECIA  
FRESENIUS VIAL  
FRESENIUS-KABI  
GIBAUD SAS GROUPE OSSUR  
HANDY BIONIC  
HEASE ROBOTICS  
IN'TECH MEDICAL  
IRT SAINT EXUPERY  
ITG  
KERANOVA  
L'ATELIER DE MAROQUINERIE - GROUPE RICHEMOND  
LEM SWITZERLAND  
LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE  
LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE  
MACOPHARMA  
MAFELEC  
MAHLE BEHR FRANCE  
MICHELIN IPO EUROPE  
MICROVITAE TECHNOLOGIES  
NEMERA  
PETERCEM  
PIAGET  
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIOR  
PLASTIVALOIRE  
POLE AEROSPACE VALLEY  
PSA GROUPE  
PURELAB PLASTICS - GROUPE GILSON  
RADIALL  
RENAULT SAS  
SAFRAN ELECTRICAL & POWER  
SAFRAN ELECTRONICS AND DEFENSE  
SALOMON SAS  
SATECO AG FRANCE  
SCHNEIDER ELECTRIC  
SKF FRANCE  
SMOBY TOYS  
SNCF RESEAU  
SODIKART  
SOFRADIM PRODUCTION  
SOMFY  
STAUBLI FAVERGES  
TECHNOFLEX  
URGO RECHERCHE INNOVATION ET DEVELOPPEMENT  
VALEO CDAS  
VALEO DAV  
VALEO PRODUCT COMBUSTION ENGINE  
VALEO THERMAL SYSTEMS  
VALEO VISION  
WILO SALMSON FRANCE  
ZODIAC AERO ELECTRIC  
ZODIAC AEROSPACE  
ETC, ...

# PARTENAIRES 2016

## Organisateur



First Connection a pour vocation d'organiser des journées d'affaires ciblées et des missions internationales sur le concept des rendez-vous préprogrammés avec pour thématique centrale l'innovation. Son objectif est de mettre en relation des offreurs et demandeurs de technologies à fort potentiel de développement comme la RFID, la mécatronique, les innovations technologiques...

## Partenaires



Réseau technologique pour les entreprises en mécatronique, productique et management de l'innovation. Depuis 14 ans, Thésame accompagne le développement de la mécatronique dans l'industrie, bien avant que cette technologie ne connaisse l'essor que nous connaissons aujourd'hui. Thésame a ainsi pu structurer le premier réseau européen industrie-formation-recherche en mécatronique qui compte aujourd'hui plus de 4000 contacts. expliquent que l'industrie aéronautique et spatiale est le principal levier d'action pour le développement de solutions innovantes de sécurité.



La plateforme S2P vise à créer une filière française de fabrication de « produits plastiques intelligents », produits à forte valeur ajoutée, grâce à la mise à disposition des entreprises de solutions de conception, fabrication, qualification et transfert, sur l'ensemble de la chaîne de valeur de développement d'un produit : faisabilité technologique, prototypage et pré-séries.

## Soutiens



## Partenaires institutionnels



## Partenaires Média

